



标准恢复整流器

ESD 防护能力

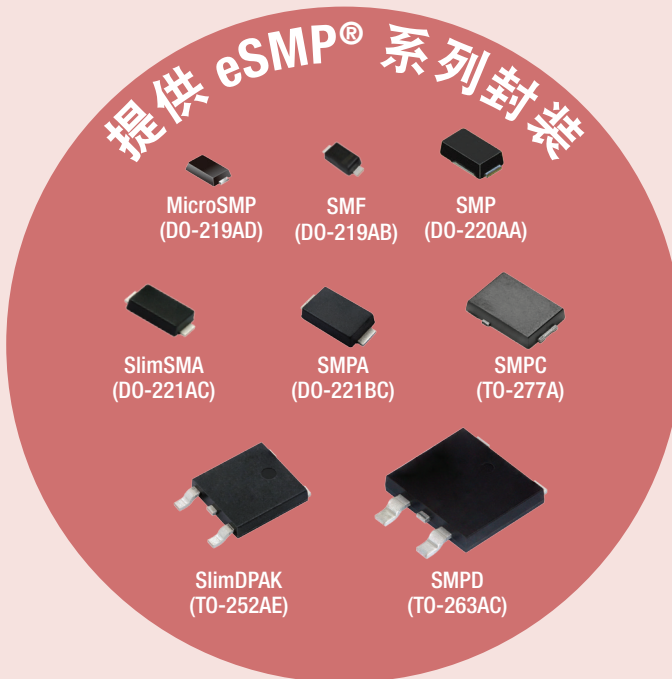
威世

特性

- 氧化物平面芯片技术
- ESD 防护能力
 - 提供基于 AEC-Q101-001 人体模型 (接触模式) 和/或 JESD22-A114 3B 类的 H3B 类 (> 8 kV) 性能



静电放电



快速了解

+175 °C 最大工作结温



低正向电压降, 低漏电流

应用



- 通用
- 极性保护
- 轨到轨保护

器件 ⁽¹⁾	eSMP® 封装	I _{F(AV)} (A)	V _{BR} 范围 (V)	最大 V _F at I _F		AEC-Q101	汽车级
				(V)	(A)		
SE07PB - SE07PJ	SMP (DO-220AA)	0.7	100 - 600	1.05	0.7	否	否
MSE07PB - MSE07PJ	MicroSMP (DO-219AD)	0.7	100 - 600	1.08	0.7	是	是
SE10PB - SE10PJ	SMP (DO-220AA)	1.0	100 - 600	1.05	1.0	是	是
MSE1PB - MSE1PJ	MicroSMP (DO-219AD)	1.0	100 - 600	1.10	1.0	是	是
MSX1PB - MSX1PJ	MicroSMP (DO-219AD)	1.0	100 - 600	1.10	1.0	是	是
SE10FD - SE10FJ	SMF (DO-219AB)	1.0	200 - 600	1.05	1.0	是	是
SE15PB - SE15PJ	SMP (DO-220AA)	1.5	100 - 600	1.05	1.5	是	是
SE15FD - SE15FJ	SMF (DO-219AB)	1.5	200 - 600	1.05	1.0	是	是
SE20PB - SE20PJ	SMP (DO-220AA)	2.0	100 - 600	1.05	2.0	是	是
SE20FD - SE20FJ	SMF (DO-219AB)	2.0	200 - 600	1.10	2.0	是	是
SE20AFB - SE20AFJ	SlimSMA (DO-221AC)	2.0	100 - 600	1.10	2.0	是	No

器件 ⁽¹⁾	eSMP® 封装	I _{F(AV)} (A)	V _{BR} 范围 (V)	最大 V _F at I _F		AEC-Q101	汽车级
				(V)	(A)		
SE20PAB - SE20PAJ	SMPA (DO-221BC)	2.0	100 - 600	1.10	2.0	是	否
SE30AFB - SE30AFJ	SlimSMA (DO-221AC)	3.0	100 - 600	1.10	3.0	是	否
SE30PAB - SE30PAJ	SMPA (DO-221BC)	3.0	100 - 600	1.16	3.0	是	否
SE40PB - SE40PJ	SMPC (TO-277A)	4.0	100 - 600	1.05	4.0	是	是
SE50PAB - SE50PAJ	SMPA (DO-221BC)	5.0	100 - 600	1.16	5.0	是	否
SE70PB - SE70PJ	SMPC (TO-277A)	7.0	100 - 600	1.05	7.0	是	是
SE80PWB - SE80PWJ	SlimDPAK (TO252AE)	8.0	100 - 600	1.12	8	是	否
SE10DB - SE10DJ	SMPD (TO-263AC)	10	100 - 600	1.15	10	是	否
SE100PWB - SE100PWJ	SlimDPAK (TO252AE)	10	100 - 600	1.14	10	是	否
SE12DB - SE12DJ	SMPD (TO-263AC)	12	100 - 600	1.15	12	是	否
SE20DB - SE20DJ	SMPD (TO-263AC)	20	100 - 600	1.20	20	是	否

(1) 反向电压, 其中: A = 50 V, B = 100 V, C = 150 V, D = 200 V, F = 300 V, G = 400 V, H = 500 V, J = 600 V

技术问题垂询: DiodesAmericas@vishay.com、DiodesEurope@vishay.com 或 DiodesAsia@vishay.com